

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成17年10月13日(2005.10.13)

【公開番号】特開2000-49061(P2000-49061A)

【公開日】平成12年2月18日(2000.2.18)

【出願番号】特願平10-211509

【国際特許分類第7版】

H 01 L 21/02

H 01 L 21/304

// H 01 L 27/12

【F I】

H 01 L 21/02 B

H 01 L 21/304 601Z

H 01 L 21/304 601S

H 01 L 27/12 B

【手続補正書】

【提出日】平成17年6月10日(2005.6.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

内部に分離用の層を有する試料を処理する処理装置であつて、

前記分離用の層の所定領域を未分離領域として残すようにして、該分離用の層で前記試料を部分的に分離する分離機構を備えることを特徴とする処理装置。

【請求項2】

前記分離機構は、前記分離用の層に向けて流体を噴射する噴射部を有し、流体により前記試料を部分的に分離することを特徴とする請求項1に記載の処理装置。

【請求項3】

前記分離機構は、前記未分離領域として略円形の領域を残すようにして、前記試料を部分的に分離することを特徴とする請求項1に記載の処理装置。

【請求項4】

前記分離機構は、前記未分離領域として略円形の領域を前記分離用の層の略中央部分に残すようにして、前記試料を部分的に分離することを特徴とする請求項1に記載の処理装置。

【請求項5】

前記分離機構は、

前記分離用の層に直交する軸を中心として前記試料を回転させる駆動機構と、

前記分離用の層に向けて流体を噴射する噴射部と、

を有し、前記駆動機構により前記試料を回転させながら該試料の部分的な分離処理を実行することを特徴とする請求項1に記載の処理装置。

【請求項6】

前記未分離領域は、前記分離用の層が分離される領域よりも小さいことを特徴とする請求項1に記載の処理装置。

【請求項7】

内部に分離用の層を有する試料を処理する処理方法であつて、

前記分離用の層の所定領域を未分離領域として残すようにして、該分離用の層で前記試料を部分的に分離することを特徴とする処理方法。

【請求項 8】

前記分離用の層に向けて流体を噴射することにより前記試料を部分的に分離することを特徴とする請求項7に記載の処理方法。

【請求項 9】

前記試料は、前記分離用の層として脆弱な構造の層を有する板状部材であることを特徴とする請求項7に記載の処理方法。

【請求項 10】

前記未分離領域として略円形の領域を残すようにして、前記試料を部分的に分離することを特徴とする請求項7に記載の処理方法。

【請求項 11】

前記未分離領域として略円形の領域を前記分離用の層の略中央部分に残すようにして、前記試料を部分的に分離することを特徴とする請求項7に記載の処理方法。

【請求項 12】

前記未分離領域は、前記分離用の層が分離される領域よりも小さいことを特徴とする請求項7に記載の処理方法。

【請求項 13】

前記試料は、脆弱な層を内部に有する第1の板状部材と、第2の板状部材とを貼り合わせることを特徴とする請求項7に記載の処理方法。

【請求項 14】

前記脆弱な層は、多孔質層であることを特徴とする請求項13に記載の処理方法。

【請求項 15】

前記第1の板状部材は、半導体基板であることを特徴とする請求項13に記載の処理方法。